

概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽。由於其僅為概要，故並無載有對閣下而言可能屬重要的一切資料，且由於在整體上受限於本文件全文，故本概要應連同本文件全文一併閱覽。務請閣下於作出投資[編纂]的決定前閱讀整份文件。

任何投資均涉及風險。投資[編纂]的部分特定風險載於「風險因素」一節。閣下於決定投資[編纂]前應細閱該節。

概覽

我們是一家專業從事印製電路板(「PCB」)研發、生產和銷售的高新技術企業。自成立以來，我們一直注重打造在工程設計、工藝技術和生產執行方面的綜合能力。我們的產品系列涵蓋單層、雙層及多層印刷電路板，包括厚銅板、金屬基板、高密度互連板(「HDI」)、高頻/高速板、超薄硬板、半孔板及其他先進PCB解決方案。其中，高密度互連板、高頻/高速板和超薄硬板等產品涉及更先進的製造工藝，通常具有更高附加值特性。近年來，我們戰略性地加大對更高附加值及特殊工藝PCB產品的投入，包括HDI板、高頻/高速板及超薄硬板，以優化產品結構，提升綜合競爭力。依託我們積累的工藝經驗和柔性生產能力，此產品組合使我們能夠滿足目標應用領域中各式各樣的性能、可靠性及定制化需求。

我們將總部設在江蘇省昆山市，並逐步在昆山及東台生產基地布下協調一致的生產格局。對於業務模式，我們採用雙軌生產策略，將大規模生產與靈活的中小批量生產結合，以滿足客戶群及下游應用場景的多樣化需求，並通過內部優化的生產調度和面板合併機制提供支持。對於單面PCB，我們以成熟的工藝標準化和多年的生產經驗積累為支撐點，將競爭重點放在規模化生產、成本效益及穩定交付表現上。對於雙面及多層PCB，我們著重執行以中小批量、多品種生產為核心的策略，依託智能化生產設備、可靠的生產工藝和嚴格的質量控制，以靈活性和快速響應為核心優先事項。這使我們能夠有效滿足客戶多樣化的產品需求及加快的產品開發與迭代週期。我們的PCB產品廣泛應用於汽車電子、消費電子、工業控制及智能家居電器產品。我們亦計劃拓展至醫療設備、光通信、人工智能(「AI」)、機器人、5G基礎設施及儲能系統等新興應用領域，該等領域對高可靠性及高性能PCB解決方案的需求持續增長。

概 要

根據弗若斯特沙利文報告，按收入計，2024年我們在中國PCB製造商中排名第42位，在長三角地區排名第6位，彰顯我們已確立的行業地位及製造能力。憑借我們的業務成就，我們已獲江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳及國家稅務總局江蘇省稅務局聯合認定為高新技術企業，體現了對我們技術實力的認可。

我們的競爭優勢

我們認為以下競爭優勢造就了我們的成功，讓我們能夠實現可持續增長：

- 憑借精準的戰略定位，捕捉多維增長機遇。我們已確立了以精準產品定位、協同製造佈局及主動響應不斷演變的客戶需求為核心的發展戰略，這使得我們能夠捕捉橫跨先現有及新興應用維度的增長機遇。
- 我們擁有廣泛的PCB產品組合及高度靈活的生產能力，能夠滿足不同應用領域客戶多樣化及不斷變化的需求。我們已構建多元的產品組合，依託靈活的多品種、中小批量生產模式，能夠高效響應客戶的多樣化需求，並支持跨多個終端市場的快速產品迭代週期。
- 我們通過持續的技術創新和研發與製造深度融合推動產品升級。我們已建立技術驅動的發展模式，將持續的工藝創新與製造執行相結合，從而能夠升級我們的產品組合，滿足高端應用領域日益複雜的技術要求。
- 我們得益於一體化產能佈局與上下游合作夥伴間協調良好的供應鏈。我們已形成一體化製造佈局及穩定的供應鏈生態系統，從而能夠高效協調生產資源，維持穩定的物料供應，並加強與供應商及客戶的協作。
- 我們依託穩定且經驗豐富的管理與技術團隊。我們擁有一支穩定且經驗豐富的管理團隊，以及多學科背景的技術及銷售人才，使我們能夠有效執行戰略，維持運營穩定，並支持業務的長遠發展。

概 要

我們的戰略

我們計劃實施以下戰略以進一步鞏固市場地位並支持長期成長：

- 推進海外產能擴張及升級智造能力；
- 提升研發能力及推進高端產品開發；
- 通過協同開發優化客戶結構與產品結構；及
- 加強能源管理與推進綠色製造。

我們的產品與應用

我們已建立一套完整的PCB產品組合，涵蓋單層、雙層及多層PCB。以下概述我們產品的特點。

產品類型	層數	技術特點	應用領域／行業
單層PCB . . .	1	<ol style="list-style-type: none">1. 導電銅箔僅層壓於基板的一側。2. 僅有一個導電層；通過通孔元件或跳線實現線路連接。3. 製造工藝成熟，適合穩定的大規模生產。	智能家居家電；中低端消費電子

概 要

產品類型	層數	技術特點	應用領域／行業
雙層PCB ...	2	<ol style="list-style-type: none">1. 雙側具有導電層，通過鍍覆孔實現兩側間的電氣連接。2. 通過化學沉銅和電鍍在孔內壁形成導電層，實現雙側間的可靠互連。3. 標準化生產工藝支持雙面電路設計，適應更多元器件安裝。	智能家居家電；中低端消費電子；工業控制電源；汽車照明
多層PCB ...	≥4	<ol style="list-style-type: none">1. 通過高精度對位和層壓工藝將多個導電層壓合在一起，在有限空間內實現複雜電路設計。2. 通過激光鑽孔、樹脂塞和機械鑽孔實現層間互連，提供卓越電氣性能。3. 內層厚銅和導熱孔有效傳量，增強長期穩定性、可靠性及熱性能。	汽車電子；高端消費電子；工業控制；醫療器械；光通信；AI服務器；人工智能應用

概 要

我們的產品覆蓋汽車電子、消費電子、工業控制系統及家用電器等多元化下游領域。除四大應用領域外，我們還計劃擴大我們在醫療器械、光通信、人工智能及機器人應用領域的佈局。這些領域亟需具有高可靠性、穩定性能和嚴格工藝控制的PCB產品，涉及長期使用、持續運行及符合行業特定標準的應用尤其如此。

汽車電子

我們的PCB產品廣泛應用於汽車電子應用，應用範圍涵蓋智能駕駛系統，車輛控制系統，智能座艙及電動汽車充電設備等。我們為電池管理系統、逆變器、電機驅動模塊及電子控制單元等應用提供PCB產品，這些應用需要穩定的信號傳輸、高載流能力和有效的散熱。為了滿足不斷變化的行業需求，我們加強了在厚銅加工、高溫材料和多層集成等領域的製造能力。

消費電子

我們的PCB產品廣泛應用於消費電子，包括筆記本電腦、平板設備、可穿戴設備和物聯網產品。該領域以產品快速迭代、對小型化、輕量化設計以及高性能計算的要求不斷提高為特點。我們的產品旨在支持高電路密度、精確阻抗控制以及在緊湊外形下的穩定信號傳輸。我們運用先進製造工藝來確保微孔成型和層間對準的精度，從而保障高頻高速應用的可靠性能。

工業控制

我們的PCB產品應用於工業控制領域，包括工業電源、控制系統、伺服系統及變頻驅動器。此類應用通常要求在高強度運作條件下具備高度的電氣精準度、運作穩定性及耐用性。工業環境通常涉及溫度波動、震動、電磁干擾及濕度等因素。因此，我們的PCB產品專為具備強大電磁兼容性、可靠性及長使用壽命而設計，以支持持續穩定運作。

智能家居家電

我們的PCB產品應用於多種智能家居家電，包括電視、空調、掃地機器人及可穿戴設備。此類應用要求PCB在持續運作下具備穩定的電氣性能、耐熱性及耐用性。隨著智能及互聯家電的日益普及，對更高密度及更複雜的PCB解決方案的請求亦有所增長。我們的產品支持在有限空間內需要高效電源管理、傳感器集成及連接性的應用。

概 要

技術及研發

我們的製造能力得益於長期投入研發，從根本上得到增強及鞏固。經過多年持續投資，我們已建立涵蓋技術開發、工藝創新、產品工程及客戶聯合開發的研發體系，形成在多品種生產條件下支持更高附加值PCB產品產業化的技術基礎。我們的研發工作專注於優化PCB核心製造工藝、拓展特殊製程能力，以及強化高端產品(尤其是汽車電子(包括智能駕駛)及光通信領域)的技術儲備。該等舉措支持持續優化產品組合，並增強抵禦行業週期波動的能力。

以下代表性技術體現了我們對工程卓越性、成本優化及產品可靠性的承諾：

- 分段式金手指加工技術
- 電漿除膠渣技術
- 精密阻抗控制技術
- 離子污染控制技術
- 精密外型加工技術
- 高精度線路成形技術
- 銅面粗化增強技術
- 高精度線路影像轉移技術

我們的研發成果得到自主開發的知識產權組合的支持。截至2025年12月31日，我們持有91項專利，其中包括發明專利17項及實用新型專利74項，全部通過自主研發獲得。該等專利涵蓋特殊孔鑽孔、熱管理結構、電鍍技術、表面處理工藝及高端PCB結構設計等關鍵領域。我們的能力亦獲得一系列國際行業認證的進一步驗證，包括ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001、ISO14064、IATF16949、QC080000、CQC及UL，共同彰顯我們在質量、環境、能源管理、安全及產品合規體系方面的成熟度。

概 要

製造

我們採用雙軌生產策略，將大規模生產與靈活的多品種、中小批量生產相結合。這種策略使我們能夠滿足不同應用領域多樣化的客戶需求以及快速變化的產品規格要求。我們以位於昆山和東台的兩個核心生產基地為依託，構建了協同聯動的雙基地製造體系，兩大基地在整體製造架構下服務於不同的產品品類。

昆山工廠專注於傳統單面板的穩定規模化生產，為需求成熟穩定的產品品類提供可靠、一致的產出。該工廠在保障應用領域成熟的產品的供應穩定、成本效益及標準化製造表現方面發揮關鍵作用。東台工廠專注於高附加值PCB產品的生產，包括雙層及多層PCB、金屬基板、HDI板、高頻／高速材料線路板、背板及超薄板等。東台工廠採用適配更高技術複雜度與可靠性要求的工藝佈局，並持續推進產能擴充。

我們的生產體系不僅依託標準化的製造流程，亦得益於多年運營積累的先進工藝技術與數字化管理能力。除在PCB製造各環節(數據工程、鑽孔、電鍍、影像轉移、蝕刻、阻焊、成型及表面處理等)建立清晰的作業規範外，我們還引入MI/CAM自動化、設計防錯系統及智能數據處理工具，提升工程精準度、工藝穩定性及生產效率，支撐多品種、高附加值PCB產品的穩定產業化。我們的製造平台同時具備高精度特殊孔形加工、寬窗口電鍍、高精度線路控制技術等系列技術，可生產金屬基板、HDI及超薄板等PCB，滿足多元化高要求應用場景的技術與可靠性需求。

除位於本國的製造工廠外，本公司亦正於泰國興建生產工廠，作為其海外擴展策略的一部分。泰國工廠旨在作為我們高附加值PCB產品製造能力的重要延伸，特別是針對在東南亞及其他海外市場設有製造業務的客戶。我們預計泰國工廠一期項目將於2026年下半年建成投產，二期項目計劃於2027年下半年啟動。

概 要

營銷、銷售及客戶

我們主要採用直銷模式，透過該模式，我們在產品開發及生產的整個週期中與客戶直接保持緊密及持續的溝通。鑒於我們的PCB產品具有高度定制化的特性，此模式使我們能夠迅速回應客戶需求，參與產品共同設計，並提供常規銷售活動外的綜合工程及質量服務。

我們的銷售及營銷策略強調優質產品、可靠交付和長期合作。我們並非主要依靠價格競爭，而是專注於提供技術價值、穩定供應和一致的產品性能，這對於汽車電子、工業控制等高可靠性應用領域的客戶而言至關重要。

我們服務的客戶群體廣泛且多元化，遍及中國、北美、歐洲、韓國及東南亞。我們的客戶涵蓋多個行業，包括汽車電子、消費電子、工業控制及家用電器，涉及電子製造服務、信息與通訊技術、顯示技術、智能硬件及汽車控制系統等領域。

我們的眾多客戶均為知名的跨國企業，擁有全球生產佈局。我們的海外收入主要透過與業務擴展至國際市場的長期合作國內客戶所產生。此多元化的客戶基礎增強了我們收入結構的韌性，使我們能夠參與多區域的產品開發週期。

我們的PCB產品應用於廣泛的終端場景，包括汽車控制系統、電池管理系統、消費電子設備、工業自動化設備和智能家居家電等。這些應用通常要求高可靠性、一致的工藝質量及嚴格符合規格，這與我們在多層板、厚銅板及特定應用PCB結構方面的能力高度契合。

下表載列我們於往績記錄期間的銷量。

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	銷量	銷量	銷量
		(千平方米)	
單層PCB	1,441	1,449	1,216
雙層PCB	556	577	728
多層PCB	387	489	618

概 要

供應商及採購

我們從合資格的多元化供應商採購原材料、輔助材料及生產設備，以支持本集團的PCB製造業務。我們的採購活動旨在確保供應穩定、品質一致及成本效益，鑒於原材料對PCB產品性能、可靠性及良率至關重要，上述因素均屬關鍵。我們PCB生產所用的主要原材料包括覆銅板、銅箔、銅球、半固化片、用於鑽孔、電鍍、蝕刻及表面處理的化學藥液，以及阻焊油墨及其他油墨。該等材料直接影響產品的電氣性能、散熱管理及長期耐用性等關鍵特性。我們的原材料主要採購自中國內地供應商，部分專用材料則向海外製造商採購。為緩解供應風險及價格波動，我們就主要材料類別維持多家合資格供應商，並採取與生產計劃相匹配的靈活採購策略。

競爭

PCB行業競爭激烈且佈局分散，眾多市場參與者於不同產品細分領域、終端應用場景及技術水平開展經營。競爭主要取決於產品質量、技術實力、定價、交付可靠性、客戶關係及產能等因素。

全球PCB生產主要集中於亞洲地區，尤以中國內地為核心製造基地，憑借成熟完善的供應鏈、專業技術人才及成本優勢佔據重要地位。同時，越來越多的PCB製造商正於東南亞地區擴建或新設生產設施。

行業參與者既包括具備先進技術實力的大型國際知名製造商，也包括專注於特定產品類型或細分應用市場的區域性中小型廠商。多層PCB、HDI板及特種PCB等高端PCB領域，因技術要求更為嚴苛、產品認證週期更長，且需在產品設計開發階段與客戶開展更緊密合作，通常具有較高的進入壁壘。相比之下，標準PCB產品則面臨更為激烈的價格競爭，產品差異化程度較低。

有關我們競爭格局的進一步詳情，請參閱「行業概覽」一節。

歷史財務資料概要

下表載列了我們於往績記錄期間的財務數據摘要，該數據摘錄自本文件附錄一所載的會計師報告。下文所載的財務數據摘要應與本文件內的財務報表(包括相關附註)一併閱讀，且其全部內容均須參照該等財務報表方為完整。我們的財務資料乃根據《香港財務報告準則》編製。

概 要

經營業績

下表載列我們於所示期間的選定綜合損益表：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(人民幣千元，百分除外)					
收入	984,056	100.0	1,042,754	100.0	1,179,885	100.0
銷售成本	(749,945)	(76.2)	(816,672)	(78.3)	(947,908)	(80.3)
毛利	234,111	23.8	226,082	21.7	231,977	19.7
其他收入	10,874	1.1	12,133	1.2	20,987	1.8
其他收益／(虧損)淨額	2,948	0.3	3,344	0.3	(6,155)	(0.5)
銷售及營銷開支	(14,400)	(1.5)	(15,193)	(1.5)	(17,313)	(1.5)
研發成本	(42,619)	(4.3)	(39,799)	(3.8)	(42,683)	(3.6)
行政開支	(35,537)	(3.6)	(39,846)	(3.8)	(42,527)	(3.6)
金融資產減值虧損淨額	(1,970)	(0.2)	267	0.0	(602)	(0.1)
財務成本	(13,171)	(1.3)	(8,896)	(0.9)	(4,644)	(0.4)
除所得稅前開支	140,236	14.3	138,092	13.2	139,040	11.8
所得稅開支	(22,182)	(2.3)	(14,781)	(1.4)	(14,326)	(1.2)
本公司擁有人應佔						
年內利潤	118,054	12.0	123,311	11.8	124,714	10.6

於往績記錄期間，我們主要透過銷售單層PCB、雙層PCB、多層PCB及其他(主要包括PCB製造過程中產生的副產品(即廢金屬)銷售)產生銷售收入，以及其他來源收入(主要來自投資物業的租金收入)。下表列出了我們的收入。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(人民幣千元，百分除外)					
銷售收入	971,096	98.7	1,031,579	98.9	1,169,077	99.1
— 單層PCB	263,130	26.7	254,717	24.4	216,728	18.4
— 雙層PCB	295,177	30.0	284,882	27.3	352,160	29.9
— 多層PCB	362,687	36.9	431,047	41.3	512,098	43.4
— 其他	50,102	5.1	60,933	5.9	88,091	7.5
其他來源收入	12,960	1.3	11,175	1.1	10,808	0.9
總收入	984,056	100.0	1,042,754	100.0	1,179,885	100.0

概 要

我們的收入由截至2023年12月31日止年度的人民幣984.1百萬元增加至截至2024年12月31日止年度的人民幣1,042.8百萬元，增幅為6.0%，並進一步增加至截至2025年12月31日止年度的人民幣1,179.9百萬元，增幅為13.2%。於往績記錄期間，收入的整體增加主要歸因於多層PCB產品銷售增長，反映出對高性能應用需求日益增加。特別是，受惠於銷量增長以及產品組合持續優化以朝向高附加值產品發展，多層PCB的收入在2025年顯著增加至人民幣512.1百萬元。

請參閱本文件「財務資料—經營業績關鍵項目說明—收入」。

毛利及毛利率

下表載列按產品類別劃分的毛利及毛利率：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	毛利 (人民幣元)	毛利率 (%)	毛利 (人民幣元)	毛利率 (%)	毛利 (人民幣元)	毛利率 (%)
單層PCB	57,959	22.0	54,075	21.2	47,509	21.9
雙層PCB	57,483	19.5	42,163	14.8	49,157	14.0
多層PCB	110,725	30.5	123,259	28.6	128,855	25.2
其他收入	733	1.5	643	1.1	869	1.0
其他來源收入	7,211	55.6	5,942	53.2	5,587	51.7
總計/整體	234,111	23.8	226,082	21.7	231,977	19.7

於往績記錄期間，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們的毛利分別為人民幣234.1百萬元、人民幣226.1百萬元及人民幣232.0百萬元。同期我們的整體毛利率分別為23.8%、21.7%及19.7%。整體毛利率反映定價調整、產品結構變化及成本壓力(包括原材料成本波動)的綜合影響，影響我們於往績記錄期間的成本結構及盈利能力。儘管我們的毛利率反映了產品市價下降、產品組合變動及成本壓力(包括原材料成本上漲)的共同影響，但我們實施了成本控制措施並持續優化我們的產品結構以保障財務運營。

請參閱本文件「財務資料—經營業績關鍵項目說明—毛利及毛利率」。

概 要

流動資產／(負債)淨值

下表載列於所示日期我們的流動資產及流動負債：

	於12月31日		
	2023年	2024年	2025年
	(人民幣千元)		
流動資產總值	832,081	1,170,247	1,238,382
非流動資產總值	547,923	508,097	612,830
流動負債總額	810,950	635,307	760,469
非流動負債總額	17,223	15,983	14,663
流動資產／(負債)淨值.....	21,131	534,940	477,913

我們的流動資產淨值由2023年12月31日的人民幣21.1百萬元大幅增加至2024年12月31日的人民幣534.9百萬元，主要由於(i)現金及現金等價物增加人民幣357.2元，(ii)存貨增加人民幣18.8百萬元，及(iii)貿易應收款項及應收票據略微增加人民幣(5.1)百萬元(維持相對穩定)，部分被(i)借款減少人民幣88.7百萬元及(ii)貿易應付款項及應付票據減少人民幣77.2百萬元所抵銷。

我們的流動資產淨值由2024年12月31日的人民幣534.9百萬元小幅下降至2025年12月31日的人民幣477.9百萬元，主要由於(i)貿易應付款項及應付票據增加人民幣144.9百萬元，及(ii)其他應付款項及應計費用增加，部分被(i)存貨增加人民幣99.9百萬元，(ii)貿易應收款項及應收票據增加人民幣15.8百萬元，及(iii)確認按公平值計入損益的金融資產人民幣172.1百萬元所抵銷，與現金及現金等價物減少相對應。

請參閱本文件「財務資料—綜合財務狀況表選定項目討論」。

概 要

我們的現金流量表概要

下表載列我們於所示期間的現金流量資料概要：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
經營活動所得現金流量淨額	107,442	104,311	160,198
投資活動所用現金淨額.....	(50,515)	(6,197)	(235,593)
融資活動所得／(所用) 現金流量淨額.....	(48,064)	256,221	(164,889)
現金及現金等價物的 增加／(減少)淨額.....	8,863	354,335	(240,284)
年初現金.....	39,249	48,667	405,893
年末現金.....	48,667	405,893	165,781

於往績記錄期間，我們於2023年、2024年及2025年錄得經營活動所得穩定現金淨流入分別為人民幣107.4百萬元、人民幣104.3百萬元及人民幣160.2百萬元。2024年的經營活動現金流量與2023年相比保持相對穩定，而2025年的增長主要歸因於經營業績的改善，部分被營運資金需求增加(包括存貨及貿易應收款項增加)所抵銷。2023年、2024年及2025年，投資活動所用現金淨額分別為人民幣50.5百萬元、人民幣6.2百萬元及人民幣235.6百萬元。2023年、2024年及2025年，融資活動之現金流量淨額分別為人民幣48.1百萬元(所用)、人民幣256.2百萬元(所得)及人民幣164.9百萬元(所用)。於2023年、2024年及2025年末，我們的現金及現金等價物分別為人民幣48.7百萬元、人民幣405.9百萬元及人民幣165.8百萬元。

請參閱本文件「財務資料—流動資金及資本資源」。

概 要

主要財務比率

下表載列於所示期間的若干主要財務比率：

	於12月31日／截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
盈利能力比率			
毛利率(%) ¹	23.8	21.7	19.7
淨利潤率(%) ²	12.0	11.8	10.6
流動資金比率			
流動比率(倍) ³	1.0	1.8	1.6
效率比率			
存貨周轉天數(日) ⁴	77.9	78.8	90.8
槓桿比率			
資本負債比率(%) ⁵	54.1	20.4	12.0

1. 毛利率按有關期間的毛利除以收入計算。
2. 淨利潤率按年內利潤除以有關期間的收入計算。
3. 流動比率按於有關年末的流動資產總值除以流動負債總額計算。
4. 存貨周轉天數按年初及年末存貨的平均值除以年內銷售成本再乘以365天計算。
5. 資產負債比率按於有關年末的借款總額除以權益總額計算。

請參閱本文件「財務資料—主要財務比率」一節。

我們的控股股東

於最後實際可行日期，王雪根先生、東台綏定及廣通源分別持有本公司34.94%、2.28%及1.23%。王雪根先生分別擔任東台綏定及廣通源的普通合夥人。

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，王雪根先生將有權(通過東台綏定及廣通源)行使及控制在本公司股東會行使合計[編纂]%的投票權。[編纂]後，王雪根先生、東台綏定及廣通源將根據上市規則分別構成本公司的控股股東集團。

有關我們控股股東的進一步詳情，請參閱「與控股股東關係」。

我們已與控股股東的聯繫人訂立若干交易，該等交易將於[編纂]後構成我們的持續關連交易。詳情請參閱「關連交易」。

概 要

風險因素

我們面臨的風險包括「風險因素」一節所載的各項風險。由於不同投資者在釐定風險的重要性時可能有不同的解讀及標準，閣下在決定投資我們的H股之前，應詳閱「風險因素」一節的全部內容。我們面臨的主要風險包括：(i)如果我們未能及時以具成本效益的方式開發符合客戶偏好並獲得市場認可的新產品或升級產品，我們的經營業績或會受到不利影響；(ii)我們的增長與盈利能力取決於整體經濟狀況，而整體經濟狀況轉而會可能影響我們客戶所處行業的發展；(iii)我們未來的增長部分取決於能否維繫並建立客戶關係；(iv)倘若我們的生產能力不足，或倘若我們無法維持理想的產能利用率及生產良率，將可能對滿足客戶需求的能力及獲利能力造成不利影響；及(v)我們在全球PCB行業面臨激烈競爭。

未來計劃及所得款項用途

我們估計，假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，並假設[編纂]未獲行使，我們將從[編纂]收取所得款項淨額約[編纂]港元(經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用及其他估計開支)。我們擬將[編纂]所得款項淨額用作以下用途：(i)約[編纂]% (即[編纂]港元)將用於我們泰國生產基地的第二期發展，包括購置及安裝設備、建設及翻新生產設施以及建設配套設施；(ii)約[編纂]% (即[編纂]港元)將用於購置及安裝與我們東台廠房計劃擴建相關的高密度互連板生產設備；及(iii)約[編纂]% (即[編纂]港元)將用於補充營運資金及其他一般企業用途。

股息政策

我們的股息政策須遵守中華人民共和國適用法律法規、我們的組織章程細則及董事會的酌情權，並考慮我們的財務表現、現金流量狀況、資金需求、未來業務及投資計劃、法定儲備要求以及董事會認為相關的其他因素。

於往績記錄期間，股息乃根據適用中國法律法規及本公司組織章程細則宣派及派付。任何股息的宣派及派付均須經股東在股東會上批准。

於A股上市後，本公司已採納一項股息政策，旨在平衡向股東提供合理回報與保留充足資金以支持業務發展、資本開支及長期增長的需要。於決定是否宣派股息及其金額時，董事會將考慮(其中包括)本公司的盈利能力、營運及現金流量狀況、資本開支計劃、融資需求及整體財務狀況。

概 要

	截止12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	(人民幣千元)		
末期股息.....	-	-	76,022

於2025年4月21日舉行的2024年股東週年大會上，批准派發截至2024年12月31日止年度之末期股息，每10股股份派發人民幣5.00元(含稅)。本集團於2024年12月31日尚未將此列為負債，而於截至2025年12月31日止年度內反映為截至2024年12月31日止年度之保留利潤分配。末期股息已於2025年5月16日派付。

無法保證未來會按任何特定金額或在任何特定時間宣派或派付股息。應付股息金額(如有)可能每年不同，並將視乎本公司的經營業績、財務狀況及董事會決定的其他因素而定。

[編纂]開支

本公司[編纂]開支主要包括(i)[編纂]相關開支，例如[編纂]費用及佣金；及(ii)非[編纂]相關開支，包括就[編纂]及[編纂]向我們的法律顧問及申報會計師提供服務而支付的專業費用，以及其他費用及開支。假設全數支付酌情激勵費用，[編纂]的估計[編纂]總額(按每股[編纂][編纂]港元計算，即本文件所述[編纂]範圍的中位數，並假設[編纂]未獲行使)約為[編纂]港元，佔我們所得款項總額約[編纂]%。在該等估計[編纂]總額中，我們預期支付[編纂]相關開支[編纂]港元、支付法律顧問及申報會計師專業費用[編纂]港元，以及其他費用及開支[編纂]港元。估計[編纂]中約[編纂]港元預期將於損益表中支銷，而餘額[編纂]港元預期於[編纂]時直接確認為權益扣減。截至2025年12月31日，我們並無產生任何[編纂]開支。

概 要

[編纂]統計數據

下表中的所有統計數據均基於以下假設：(i)[編纂]已完成，並根據[編纂]發行了[編纂]股H股；及(ii)[編纂]完成後，已發行並流通在外的A股為152,044,663股。

	根據[編纂] 每股H股[編纂] 港元計算	根據[編纂] 每股H股[編纂] 港元計算
本公司股份市值 ⁽¹⁾	[編纂]港元	[編纂]港元
未經審核備考經調整每股 有形資產淨值 ⁽²⁾	[編纂]港元 (人民幣[編纂] 元)	[編纂]港元 (人民幣[編纂] 元)

附註

1. 本公司股份市值的計算基於(i)預計發行的[編纂]股H股；及(ii)已發行的152,044,663股A股，按截至最新實際可行日期前五個交易日本公司A股每股平均收市價人民幣35.74元(相當於約[40.65]港元)計算。詳情請參閱本文件「股本——我們的股本」一節。
2. 於2025年12月31日，本公司擁有人應佔本集團未經審核備考經調整每股有形資產淨值，乃經前述段落所述調整後，並假設[編纂]已於2025年12月31日完成，已發行股份總數合計為[編纂]股，但未計及本公司因[編纂]獲行使而可能配發及發行的任何股份。於2025年12月31日，本公司擁有人應佔本集團未經審核備考經調整每股有形資產淨值，基於每股[編纂][編纂]港元、[編纂]港元及[編纂]港元的[編纂]計算，將分別為人民幣[編纂]元([編纂]港元)、人民幣[編纂]元([編纂]港元)及人民幣[編纂]元([編纂]港元)。
3. 除上文所披露者外，本公司擁有人應佔本集團未經審核備考經調整每股有形資產淨值並未作出任何其他調整，以反映本集團於2025年12月31日之後進行的任何交易結果或其他交易。

近期進展及無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，自2025年12月31日(即本公司最新經審核合併財務報表的編制日期)以來，且自2025年12月31日以來，並無任何事件會對本文件附錄一「會計師報告」所載之綜合財務報表所顯示之資料造成重大影響。